PASJ2021 MOP010

溶接ステンレス板を使った大口径ピローシールの開発

DEVELOPMENT OF A LARGE-DIAMETER PILLOW-SEAL USING WELDED STAINLESS-STEEL PLATES

倉崎 るり^{#A)}, 山野井 豊^{A)}, 渡邉 丈晃^{A)}, 中村 哲朗^{B)} Ruri Kurasaki^{#, A)}, Yutaka Yamanoi^{A)}, Hiroaki Watanabe^{A)}, Tetsuro Nakamura^{B)} ^{A)} Institute of Particle and Nuclear Studies, High Energy Accelerator Research Organization (KEK) ^{B)} MIRAPRO CO., LTD.

Abstract

At the J-PARC Hadron Experimental Facility, a new beamline is now under construction for the COMET experiment using 8 GeV protons, in which a large diameter superconducting solenoid magnet with an inner diameter of 1200 mm is adopted. Since a target for muon production is installed in the center of the solenoid magnet, radiation level is expected to be very high around the magnet. In order to reduce the radiation exposure of workers, we plan to employ a large-diameter all-metal pillow seal for the vacuum connections around the magnet. To fabricate such a large-diameter pillow-seal, a stainless-steel plate with a radius of 1.5 m and a thickness of 0.2 mm is necessary. However, as of now, it is not able to procure such a large "seamless" plate. Thus, we have examined two types of a "welded" plate using a small-size pillow-seal to measure an airtightness performance. The results show that the airtightness of the welded-plate pillow-seal meets our requirement. We are now preparing a real-size pillow-seal using a welded plate to establish a fabrication procedure and to evaluate the performance.

1. はじめに

J-PARC ハドロン実験施設では、30 GeV に加速された 陽子ビームを利用して、多くの原子核・素粒子実験が実 施されている[1]。現在、Fig. 1 のように新たなビームライ ンとして、COMET ビームラインの建設を進めている。

COMET 実験[2]は、J-PARC の主リングからの 8 GeV 陽子ビームをパイ中間子生成標的に照射し、後方へ発 生したパイ中間子をソレノイド磁場で捕獲し、下流の ミューオン粒子静止標的まで輸送し静止させる。

この捕獲ソレノイド電磁石は超伝導電磁石となってお り、中心部にはパイ中間子標的が置かれ、超伝導状態 のクエンチ防止のためにソレノイド遮蔽体が設置される。 ソレノイド遮蔽体は8 GeV 陽子ビーム下流(Fig. 2 の右) に退避できる構造となっており、ソレノイド電磁石とソレノ イド遮蔽体を真空接続する必要がある。ビーム前方とな る接続部周辺は高放射化が予想されており、作業者の 被ばく量低減のために、真空接続には遠隔からの真空 接続・切り離しが可能なピローシールを採用する[3-6]。

Figure 2 のように、捕獲ソレノイド電磁石のクライオス タット下流部の有効径は φ 1200 mm である。そのため、 従来にない大口径のピローシール装置が必要となった。

大口径ピローシールの開発で最大の懸念事項は、ダ イヤフラムのための継目のないステンレス材を製造また は入手が困難なことである。ダイヤフラムは極めて平滑な 金属表面同士が接触して真空気密性を発揮する。そこ で、複数のステンレス板を溶接で繋いで製造したダイヤ フラムを小型のピローシールに組み込んで気密試験を 実施することにした。本論文では、溶接型ダイヤフラムを 使った小型ピローシールの気密性能の結果を報告する。



Figure 1: Plan view of the Hadron Experimental Facility at J-PARC.



Figure 2: Drawing of a large-diameter pillow-seal and a solenoid magnet with a radiation shielding unit.

2. 大口径ピローシール

2.1 ピローシール

ピローシールは Fig. 3 のように、鏡面研磨された金属 ダイヤフラムを圧縮空気で空気枕(ピロー)のように膨ら

[#]ruri.kurasaki@kek.jp

Proceedings of the 18th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 9 - 12, 2021, QST-Takasaki Online, Japan

PASJ2021 MOP010

ませ、同じく鏡面研磨されているミラーフランジへ密着させることで真空気密を得ることができる真空着脱装置である。遠隔からの圧縮空気の On/Off のみで真空の接続・切り離しが可能で、さらにすべて金属材料(有機材料を使用していない)で構成されているため耐放射線性に非常に優れている[3-6]。そのため、近接作業が困難なハドロンビームラインの高放射化エリアなどで多く採用されている。



Figure 3: Schematic drawing of a pillow-seal.

2.2 大口径ピローシールの仕様

捕獲ソレノイド電磁石のクライオスタット下流部の有効 径はφ1200 mm で、片側フランジが固定されもう片方が 伸縮する片持ち型のピローシールである。伸縮長は 10 mm 程度になるように、ベローズは成形ベローズ 4 山 とした。

また、ピローシール全体としての要求されているヘリウム気密性能は 1E-8 Pa・m³/sec 以下である。

大口径ピローシール実機を製作する前段階として、溶 接ステンレス板のダイヤフラムを使った小口径のピロー シールを製作し、性能の確認を行った。その詳細は次節 で説明する。

3. 溶接ステンレス板ダイヤフラム試験

3.1 溶接ステンレス板ダイヤフラムの1重ピローシール

溶接ステンレス板を使ったダイヤフラムの性能を確認 するために、口径 110 mm サイズのダイヤフラムを作って 1 重ピローシールを製作した。Figure 4 のようにステンレ ス板を 2 種類の配置で溶接後、固溶化熱処理を行い、 内外径加工後に電解複合研磨してダイヤフラム材として 使用した。出来上がったダイヤフラムは Fig. 5 である。試 験用のピローシールはダイヤフラム材の性能が測定しや

すいようにダイヤフラムは1重とした。

溶接後および固溶化熱処理後にマイクロビッカース硬度計で硬度測定を行った結果を Table 1 に示す。なお、 ステンレス板(母材)の硬度は 370 から 400 である。

Figure 6 は口径 110 mm のダイヤフラム評価用のピ ローシールである。加圧や減圧によりピローシールを伸 縮させてみたところ動きに問題がないことを確認した。



Figure 4: Schematic drawings of the welded plate for the diaphragm.



Figure 5: Photographs of the diaphragm made from a 45-degree welded plate.

Table 1: Results for Hardness Measurement by a Micro Vickers Hardness Tester, Where the Unit is HV

Hardness measurement (HV)	Base plate	Welded seam
After the welding	372	244
After the heat treatment	129	135



Figure 6: Photograph of the pillow seal with the diaphragm made from the welded plate.

3.2 ヘリウムリーク試験

用意したダイヤフラムサンプルは、(A)継目なし、(B) 溶接部 90 度、(C)溶接部 45 度の 3 種類である。

それぞれに対して、ヘリウムリーク試験は2通りの条件 で行った。(1)ダイヤフラム圧力一定でベローズ圧力を 変化させる方法と、(2)ベローズ圧力一定でダイヤフラム 圧力を変化させる方法である。

実機の運用と同じように、加圧順序は、先にダイヤフラ ムを加圧してからベローズ加圧を行い、真空排気したの ち、ヘリウムを吹きかけてヘリウムリーク試験を実施した。 溶接ステンレス板を使ったダイヤフラムの場合は溶接部 にヘリウムを吹きかけている。

ヘリウムリーク試験の結果を Fig. 7 および Fig. 8 に示 す。(1)ダイヤフラム圧力一定でベローズ圧力を変化さ せたときの結果が Fig. 7 で、(2) ベローズ圧力一定にして ダイヤフラム圧力を変化させたときの結果が Fig. 8 である。

結果より、(B)と(C)の溶接継目ありのダイヤフラムは (A)継目なしダイヤフラムと比べて、ヘリウムリーク量が約 10倍大きい。

また、Fig. 7 からベローズ圧力は気密性能には大きな 影響を与えていないのに対し、Fig. 8 からダイヤフラム圧 力は気密性能に一定の影響があることが確認された。



Figure 7: Results of the helium-leakage rate as a function of the bellows pressure, where the diaphragm pressure is fixed to be 0.35 MPa.



Figure 8: Results of the helium-leakage rate as a function of the diaphragm pressure, where the bellows pressure is fixed to be 0.35 MPa.

3.3 プレスケールによる接触幅の測定

FUJIFILM 社製の圧力測定フィルムプレスケール[7]を 使ってダイヤフラムの接触幅の測定を行った。

ヘリウムリーク試験と同様に、用意したダイヤフラムサンプルは、(A)継目なし、(B)溶接部 90 度、(C)溶接部 45 度の 3 種類、ヘリウムリーク試験は、(1)ダイヤフラム 圧力一定と(2)ベローズ圧力一定の方法である。

Figure 9 は(C)溶接部 45 度でダイヤフラム圧力が 0.35 MPa でベローズ圧力が 0.35 MPa の時のプレスケー ルの結果である。接触幅の測定結果を Fig. 10 および Fig. 11 に示す。(1)ダイヤフラム圧力一定のときの結果 が Fig. 10、(2)ベローズ圧力一定のときの結果が Fig. 11 である。接触幅は赤色化したドーナツ形状部分の 4 カ所 の平均値である。(A)継目なしは(B)と(C)の溶接継目 ありに比べて接触幅が大きい。また、(1)ダイヤフラム圧 一定の時、ベローズ圧力がダイヤフラム圧力以上になる と接触幅は大きくならない。また、接触幅の大きさはヘリ ウムリーク量には大きく影響がしないことが分かった。



Figure 9: An example of pressure distribution in case (c). The pressures on the diaphragm and bellows are 0.35 MPa and 0.35 MPa, respectively. The dark red area indicates high pressure.

PASJ2021 MOP010



Figure 10: Results of the contact width of the diaphragm as a function of the bellows pressure, where the diaphragm pressure is fixed to be 0.35 MPa.



Figure 11: Results of the contact width of the diaphragm as a function of the diaphragm pressure, where the bellows pressure is fixed to be 0.35 MPa.

3.4 大口径ピローシールの場合

今回の試験結果を実機の口径 1200 mm のピローシー ルに適用した場合の気密性能を求めた。今回の口径 110 mm のピローシールのヘリウムリーク量(ベローズ圧 力 0.35 MPa,ダイヤフラム圧力 0.35 MPa)から口径 1200 mm のピローシールのヘリウムリーク量を予想する。

外部からのリーク量 Q_2 が気密性能を示す。 Q_2 は形状因子であるダイヤフラムのコンダクタンス Cにより、次のように表せる[3]。

$$Q_2 = \frac{C^2 P_0}{S_1}$$

 P_0 :大気圧

S1:中間排気速度

ここでコンダクタンス C は、面粗度 A(算術平均粗さ Ra)、ダイヤフラム周長 L、ダイヤフラム幅 w、押し付ける 圧力 F、フォルム材質の塑性変形耐力 R を用いて Roth[8]により、次のような関係があることが示されている。

 $C = 34A^2 \left(\frac{L}{w}\right) \exp\left[-\frac{3F}{LwR}\right]$

ダイヤフラムの面粗度 A、使用条件である押し付ける 圧力 F、フォルム材質の塑性変形耐力 R は同じとする。 $exp\left[-\frac{1}{Lw}\right]$ はおよそ 1 となるため、ダイヤフラム周長 L と 幅 w は形状サイズで比例させることとする。

今回の試験装置のコンダクタンスをC(110)、実機のコンダクタンスをC(1200)とする。それぞれのダイヤフラムの幅wは20mmと30mm、周長Lは570mmと4340mmであるから、

$$C(1200) \propto \frac{4340}{30} \frac{20}{570} C(110) = 5.1 \times C(110)$$

ダイヤフラムサンプル(A)継目なしの場合、
$$0_{-}$$
 10F - 7

$$C(110) = \frac{C_1}{P_0 - P_1} = \frac{1.02}{101325 - 0.93}$$

$$= 9.9E - 13 \text{ m}^{3}/\text{sec}$$

$$C(1200) = 5.0E - 12 \text{ m}^{3}/\text{sec}$$

$$Q_{2} = \frac{C(1200)^{2}P_{0}}{S_{1}} = \frac{(5.0E - 12)^{2} \times 1E5}{3.0E - 5}$$

$$= 8.3E - 14 \text{ Pa} \cdot \text{m}^{3}/\text{sec}$$

と見積もられる。同様に継目の有るサンプル(B)、(C)の C(1200)を求めると、(B)は 8.3E-12 Pa・m³/sec、(C)は 1.3E-10 Pa・m³/sec と予想され、いずれの場合も設計基 準性能 1E-8 Pa・m³/sec 以下を満たしている。従って、溶 接継ぎ目のあるステンレス材を使ったダイヤフラムによる 大口径ピローシール実機の製造可能性が得られた。

しかし、これまでの口径 300 および 500 のピローシー ル実機では、リーク量はもっとも良い結果で 1E-11 台で あった。そのため、上記の(A)継目なしで 2 桁悪くなる可 能性がある。他の(B)および(C)においても同様に 2 桁悪 くなる可能性があるが、設計基準性能 1E-8 Pa・m³/sec 以 下を満たせる可能性はまだ十分ある。そのためにも、口 径 1200 mm の実機サイズのピローシールで性能を検証 する必要がある。

4. まとめ

溶接ステンレス板を使った大口径ピローシールの開発 のために、口径 110 mm サイズのピローシールにより、溶 接ステンレス板ダイヤフラムの性能確認を行った。

溶接ステンレス板を使うことにより、これまで使用してき たシームレス板と比べて平滑度が悪くなり、その影響で 気密性能の悪化が懸念されていたが、要求されたヘリウ ムリーク性能はクリアしているという結果が得られた。この 結果より、実機に適用可能であることが示された。

今後は実機である口径 1200 mm の大口径ピローシー ルを製作し、製作方法の確立および気密性能の検証を 実施する予定である。

参考文献

- [1] A list of experiments in the J-PARC Hadron-hall; http://research.kek.jp/group/nuclpart/HDeppc/Exp/
- [2] COMET experiment; https://comet.kek.jp
- [3] Y. Yamanoi et al., "Development of Pillow Sealing for J-

Proceedings of the 18th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 9 - 12, 2021, QST-Takasaki Online, Japan

PASJ2021 MOP010

PARC Hadron Beamline", Proceedings of the 2nd Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2005, pp. 736-738, LAM736.

- Y. Yamanoi *et al.*, "Development of Vacuum Sealing Devices for J-PARC Hadron Beamline", Proceedings of the 3rd Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2006, pp. 472-474, WP68.
- [5] Y. Yamanoi *et al.*, "Effect of surface roughness on leak tightness of pillow seal", Proceedings of the 4th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2007, pp. 826-828, FP59.
- [6] R. Kurasaki *et al.*, "Development of a long-stroke pillow-seal for the J-PARC Hadron High-P beamline", Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2019, pp. 302-306, WEPH013.
- [7] https://www.fujifilm.com/products/measurement_ film/en/prescale/product/
- [8] A. Roth, Vacuum technology, Fourth impression 1998, ISBN 0-444-88010-0 (Elsevier).